



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080109001

2008 年 2 月 3 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)SOIC 18pin DWパッケージ一部製品 組立サイト追加変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	■Initial notice (Plan)		□Final notice	
変更概要	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical
	Wafer Fab	□Site	□Process	□Material
	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material
	■Assembly	■Site	□Process	□Material
	Test	□Site	□Process	
	Others	□Packing/Shipping/Labeling		□ -
変更内容	SOIC 18pin DW パッケージ一部製品 組立サイト追加変更 現行 ：CARSEM 社(マレーシア) 変更後：CARSEM 社(マレーシア)及びUTL 社(旧 NS2)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	4 月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルに関しましては、2 月 29 日以降となります。)			
品質認定試験	■計画		□終了	
製品表示	□変更無し		■変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。
最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、本PCNの更新版として認定試験の結果を含め、変更品の出荷に先立つ30日以前に、変更通知の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) SOIC 18pin DWパッケージ一部製品について、現行、CARSEM 社(マレーシア)にて製造いたしておりますが、これに加えUTL社 (IHNS2) での製造を追加し認定する予定です。この変更に伴い、一部部材の変更が発生しますが、共に既に量産に適用されている部材になります。尚、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。

変更項目	現行	変更後
組立サイト	CARSEM社(マレーシア)	CARSEM社(マレーシア) UTL社 (IHNS2)
マウントコンパウンド	ABLESTIK 8290	ABLESTIK 8290 ABLESTICK 8200T
モールドコンパウンド	SUMITOMO G600C	SUMITOMO G600C SUMITOMO G605T

理由：供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
UC2526ADW	UC2871DWG4	UC3526ADW	UC3841DWTRG4	UC3903DW
UC2526ADWG4	UC2874DW-1	UC3526ADWG4	UC3851DW	UC3903DWG4
UC2526ADWTR	UC2874DW-1G4	UC3526ADWTR	UC3851DWG4	UC3903DWTR
UC2526ADWTRG4	UC2874DW-2	UC3526ADWTRG4	UC3851DWTR	UC3903DWTRG4
UC2544DW	UC2874DW-2G4	UC3526DW	UC3851DWTRG4	UC3914DW
UC2544DWG4	UC2874DWTR-2	UC3526DWG4	UC3874DW-1	UC3914DWG4
UC2841DW	UC2874DWTR-2G4	UC3526DWTR	UC3874DW-1G4	UC3914DWTR
UC2841DWG4	UC2914DW	UC3526DWTRG4	UC3874DW-2	UC3914DWTRG4
UC2851DW	UC2914DWG4	UC3841DW	UC3874DW-2G4	
UC2851DWG4	UC2914DWTR	UC3841DWG4	UC3874DWTR-1	
UC2871DW	UC2914DWTRG4	UC3841DWTR	UC3874DWTR-1G4	

製品表示

UTL 社(旧 NS2)の組立サイト・コード("S")は、"B"となります。(CARSEM 社(マレーシア)："V"です。)組立サイト・コードが、"V"に加え"V"及び"B"となります。

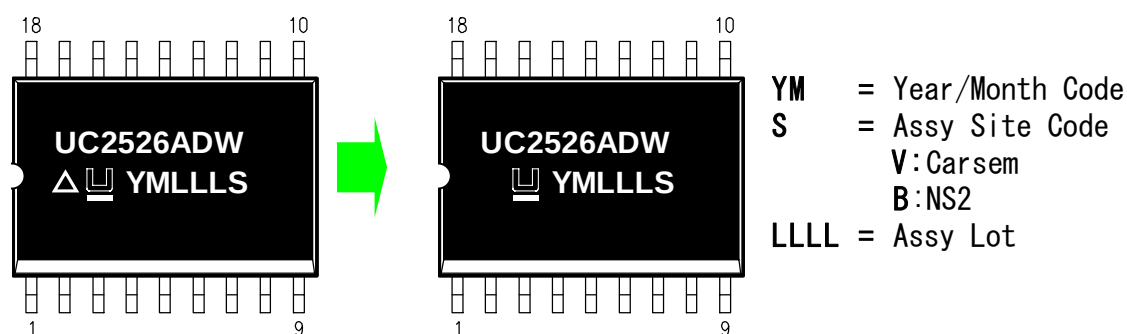


図1. 製品表示の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2008 年 8 月	終了	2008 年 4 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device	UC2526A	Die Size (mils)	116.0 X 97.0	
Wafer fab Site	SHE	Technology	Bi-POLAR	
Fab Process	BIP-SLM	Metal 1	AL Cu	
Assembly Site	NS2	Package / Pin	DW / 18	
Mount compound	8200T	Mold Compound	G605	
Lead Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu			
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Lot x Sample size	
** Steady-state Life Test	150C, 300hrs		3Lots x 116pcs	
** Biased HAST	130C/85%RH, 96hrs		3Lots x 77pcs	
** Autoclave 121C	121C, 96hrs		3Lots x 77pcs	
** T/C -65C/150C	-65C/150C, 1000cys		3Lots x 77pcs	
Manufacturability	per mfg. Site specification		-	
X-ray	top side only		3Lots x 5pcs	
** High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs		3Lots x 77pcs	
Note: ** Preconditioning required				